



2027年3月期 第1四半期

(2026年4月1日 ~ 2026年6月30日)

決算補足資料

2026年8月10日

ENOMOTO Co.,Ltd.

東証スタンダード 証券コード:6928

2027年3月期第1四半期決算 P.03

2027年3月期業績予想 P.09

中期経営計画進捗 P.12

(1)2027年3月期第1四半期決算



- ・ 四半期での営業利益としては過去最高
- ・ オプト用リードフレームのハイエンドLED向け、コネクタ用部品のスマートフォン向けを中心に増収
- ・ パワー半導体用リードフレームは前年同期比1%減収だが、自動車向けやサーバー向けが回復、前4Q比では増収
- ・ 利益面では、増収に加え、工場稼働率と製品ミックスの改善、メッキの内製化により収益力が向上

単位:百万円	2025/3期 1Q		2026/3期 1Q		2027/3期 1Q		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前期比(%)
売上高	6,506	100.0	7,146	100.0	8,723	100.0	+22.1
売上総利益	749	11.5	940	13.2	1,404	16.1	+49.3
販管費	645	9.9	629	8.8	688	7.9	+9.4
営業利益	104	1.6	311	4.4	715	8.2	+129.9
為替差損益	5	0.1	12	0.2	△3	-	-
経常利益	135	2.1	336	4.7	706	8.1	+109.7
四半期純利益	47	0.7	263	3.7	514	5.9	+95.5
1株当たり 四半期純利益	7.04円	-	41.27円	-	77.93円	-	

四半期別業績報告(第1四半期)

- ・ オプト用リードフレーム、コネクタ用部品を中心に、売上高は25年3月期4Qをボトムに四半期比で増収継続
- ・ スマートフォンの新規モデル向けが出荷開始。ハイエンドLED向けが民生・車載ともに順調に増加
- ・ 工場稼働率と製品ミックスの改善、メッキ内製化による収益力の向上により前年同期比、前4Q比ともに大幅な増益

単位:百万円	2026/3期					2027/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前同比(%)	4Q比(%)
売上高	7,146	7,505	7,758	8,004	30,415	8,723	+22.1	+9.0
売上総利益	940	1,069	1,242	1,293	4,546	1,404	+49.3	+8.5
販管費	629	651	677	938	2,896	688	+9.4	Δ26.6
営業利益	311	418	565	355	1,650	715	+129.9	+101.2
為替差損益	12	0	5	Δ17	1	Δ3	-	-
経常利益	336	474	579	375	1,766	706	+109.7	+87.9
四半期純利益	263	325	390	252	1,231	514	+95.5	+104.0

製品群別四半期売上高(第1四半期)

- ・ パワー半導体用リードフレームは車載向けが堅調、民生・産機向けもサーバー向け中心に底打ち、4Q比では増収
- ・ オプト用リードフレームではハイエンドLED向けが民生の量産本格化に続き車載も量産開始となり、増収トレンド継続
- ・ コネクタ用部品はスマートフォンの新規モデル向け出荷が開始し堅調、車載向けとともに増収

単位:百万円	2026/3期					2027/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前同比(%)	4Q比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	2,615	2,535	2,526	2,474	10,152	2,585	△1.1	+4.5
オプト用 リードフレーム	1,108	1,205	1,226	1,649	5,190	1,746	+57.6	+5.9
コネクタ用部品	3,264	3,621	3,832	3,693	14,411	4,241	+29.9	+14.8
その他	158	142	173	186	661	149	△5.9	△19.9
合計	7,146	7,505	7,758	8,004	30,415	8,723	+22.1	+9.0

経常利益増減要因(第1四半期)

増減収効果

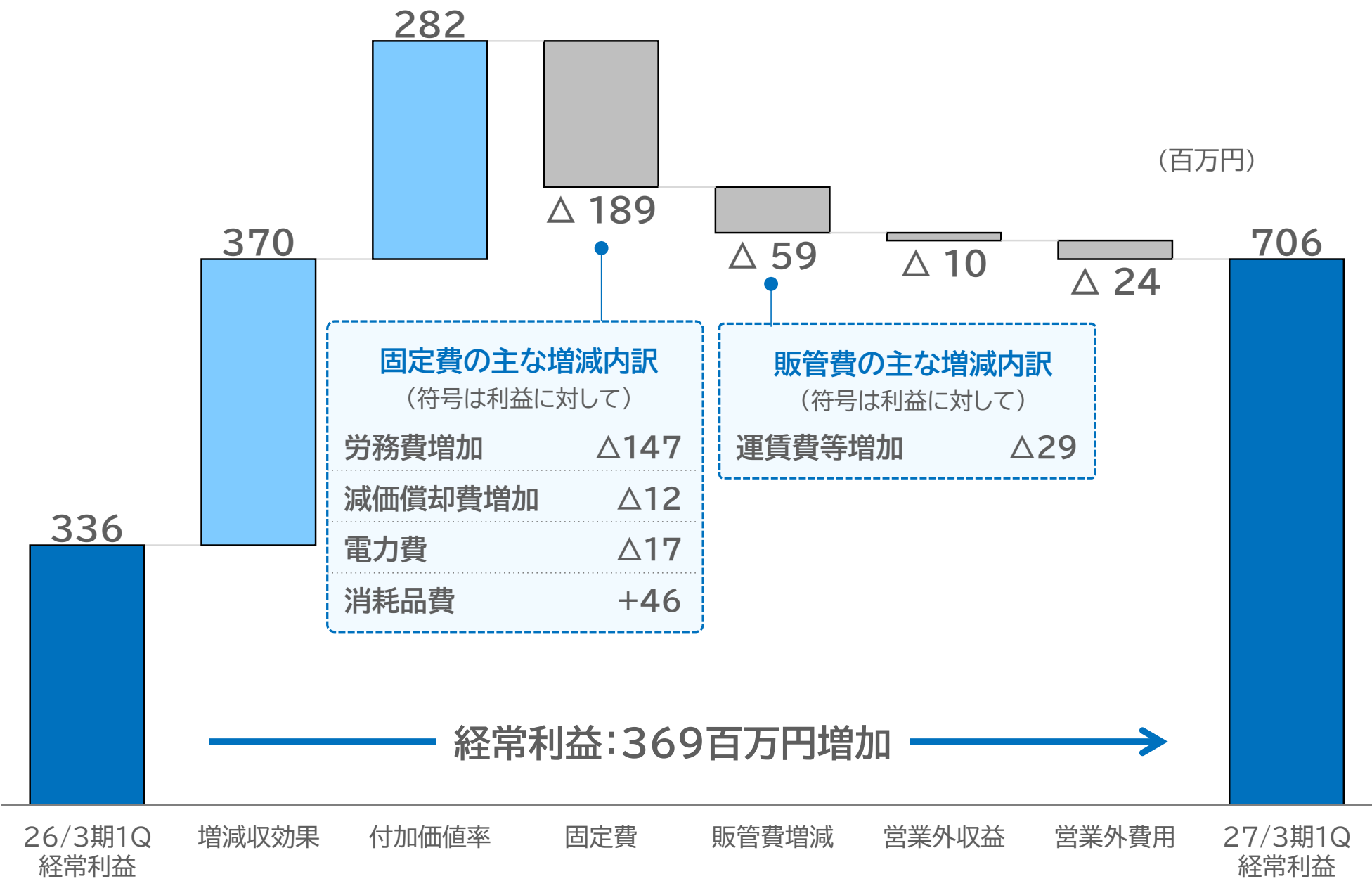
オプト用リードフレーム、コネクタ用部品のウェアラブル端末向けを中心に増収

付加価値率

- ①メッキの内製化による、付加価値の取り込み
- ②オプト用リードフレームのハイエンド品の増加

固定費・販管費

生産高増加に伴う労務費及び運賃搬送費・荷造費増加



用途別量産品売上構成比(第1四半期)

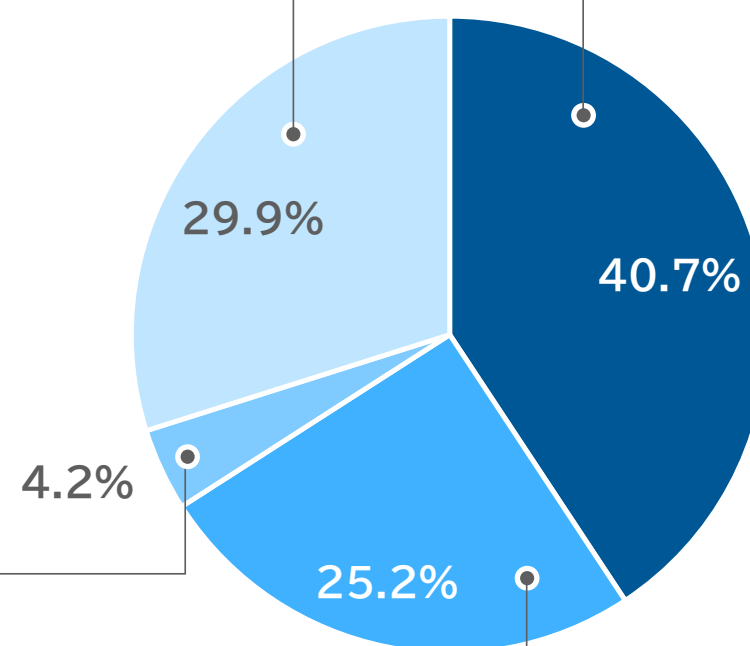
- ・ 車載はオプト用リードフレームがハイエンド品の量産開始で伸長。パワー半導体用リードフレーム、エアバッグ向けコネクタは共に堅調
- ・ スマートフォンは前期からの好調を維持しつつ新規モデル向けの出荷が開始。ウェアラブルは減少したが、新製品向けの受注は増加
- ・ 民生・産機・その他の汎用パワー半導体用リードフレームは底を脱したものの低調。オプト用リードフレームはハイエンド品が堅調に推移

民生・産機・その他

- ・ 構成比は前年同期の28.7%から1.2pt増加
前年同期比28.7%増加
- ・ 高性能パワー半導体用リードフレームは復調
- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品が大幅増

ウェアラブル

- ・ 構成比は前年同期の5.7%から1.5pt減少
前年同期比10.5%減少
- ・ 新製品に向けた金型製作は堅調、2Q以降に期待



車載

- ・ 構成比は前年同期の42.0%から1.3pt減少
前年同期比19.5%増加
- ・ オプト用リードフレームの車載向けが伸長
- ・ xEV向けパワー半導体用リードフレーム、
エアバッグ向けコネクタ等は共に堅調

スマートフォン

- ・ 構成比は前年同期の23.6%から1.6pt増加
前年同期比32.0%増加
- ・ スマートフォン向けコネクタ部品の新規モデル向け
が出荷開始となり、好調に推移

(2)2027年3月期業績予想



業績予想

- ・ 売上高・利益とも上方修正、営業利益は中期経営計画の目標値である24億円に上方修正し、最高益を目指す
- ・ パワー半導体用はサーバー向けが牽引、オプト用はハイエンド品の量産立上が順調、コネクタはスマートフォン向けが上振れ
- ・ 利益面では増収に加え、メッキ内製化による付加価値の取り込みや、工程改善等による収益力向上が業績に寄与

単位:百万円	2026/3期		2027/3期				
			期初予想		今回予想		
	実績	売上比(%)	予想	売上比(%)	予想	売上比(%)	前期比(%)
売上高	30,415	100.0	32,000	100.0	34,000	100.0	+11.8
売上総利益	4,546	14.9	4,700	14.7	5,200	15.3	+14.4
販管費	2,896	9.5	2,700	8.4	2,800	8.2	△3.3
営業利益	1,650	5.4	2,000	6.3	2,400	7.1	+45.4
経常利益	1,766	5.8	2,000	6.3	2,400	7.1	+35.8
当期純利益	1,231	4.0	1,400	4.4	1,750	5.1	+42.1
1株当たり当期純利益	191.21円	-	217.38円	-	265.10円	-	-
配当金	75.0円	-	77.0円	-	80.0円	-	-

製品群別売上高予想

- ・ パワー半導体向けリードフレームは車載向けの回復に加え、民生・産機ではサーバー向けがけん引して復調
- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品が車載向けを中心に順調に量産立ち上げ、着実な成長が続く
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン向けなどの需要が期初予想を上回り、高い水準で推移

単位:百万円	2026/3期		2027/3期				
			期初計画		今回予想		
	実績	構成比(%)	予想	構成比(%)	予想	構成比(%)	前期比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	10,152	33.4	10,000	31.3	11,000	32.4	+8.4
オプト用 リードフレーム	5,190	17.0	7,000	21.9	7,000	20.6	+34.9
コネクタ用部品	14,411	47.4	14,500	45.3	15,500	45.6	+7.6
その他	661	2.2	500	1.5	500	1.5	△24.4
合計	30,415	100.0	32,000	100.0	34,000	100.0	+11.8

(3) 中期経営計画進捗



『2nd STEP』(2027年3月期修正予想)

- ・ 2027年3月期予想を上方修正。中期経営計画に対し、売上高は上振れ、営業利益は計画達成を目指す
- ・ 営業利益は『2nd STEP』初年度の2025年3月期の6億円から27年3月期には24億円へ急回復する見通し
- ・ 車載向けLEDリードフレームや高周波対応コネクタ部品、ウェアラブル端末向けマイクロコネクタ部品も立ち上がっており、『3rd STEP』でも成長を続け、『ビジョン 2030』の実現を目指す

2nd STEP最終年度 期初予想

売上高
320億円

営業利益
20億円
(利益率6.3%)

ROE
6.0%

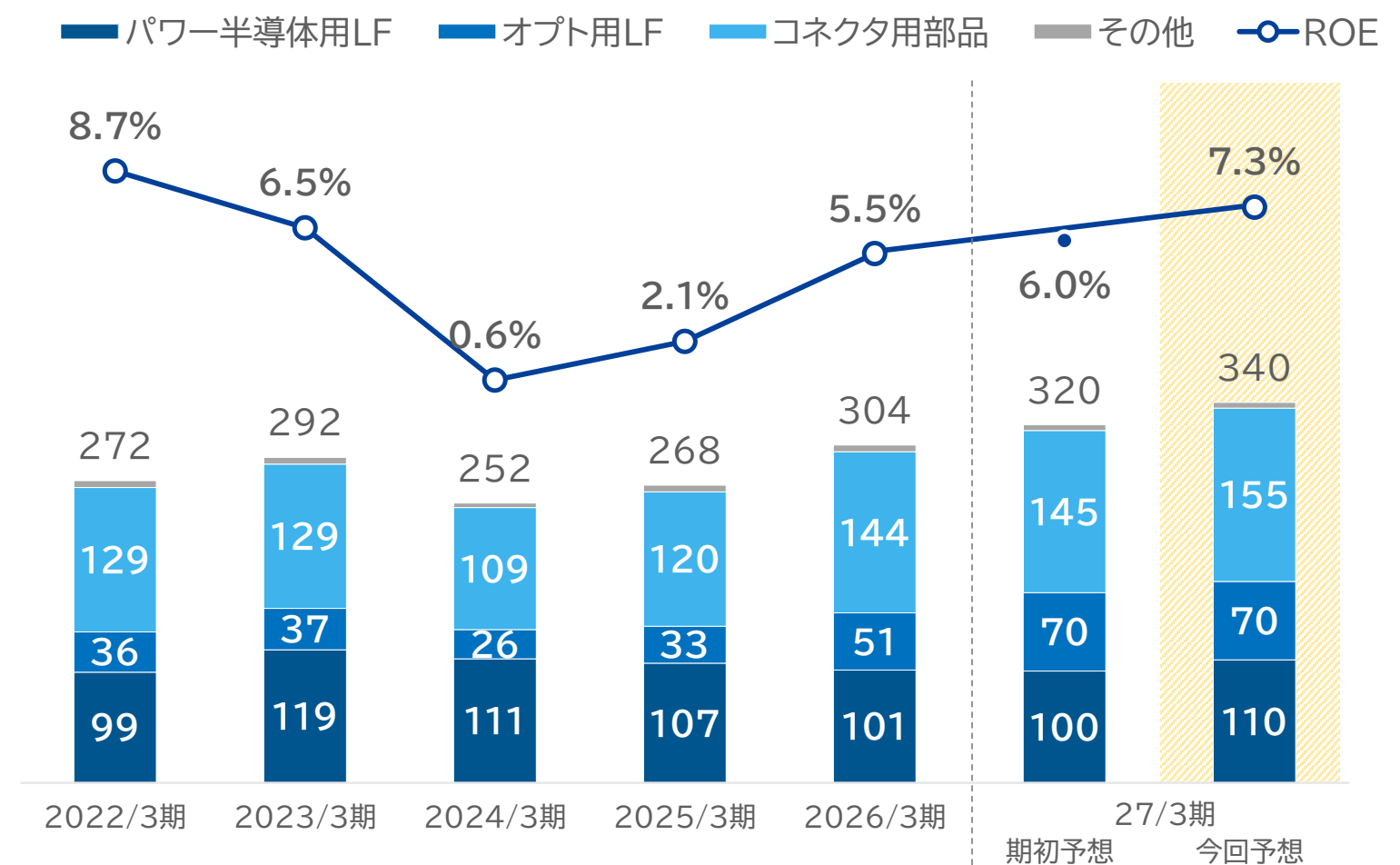
2nd STEP最終年度 今回予想

売上高
340億円

営業利益
24億円
(利益率7.1%)

ROE
7.3%

売上高・ROE



(当初計画)『2nd STEP』(2025年3月期～2027年3月期)

- 自動車向けパワー半導体用リードフレームやハイエンドLED等の成長分野への投資により、2nd STEP最終年度は売上高300億円を計画
- 増収に加えて、メッキ工程の内製化やスマートファクトリーの推進による生産効率向上により営業利益は24億円、利益率も8.0%を計画

1st STEP実績(3カ年平均)

売上高
272億円

営業利益
12億円

ROE
4.7%

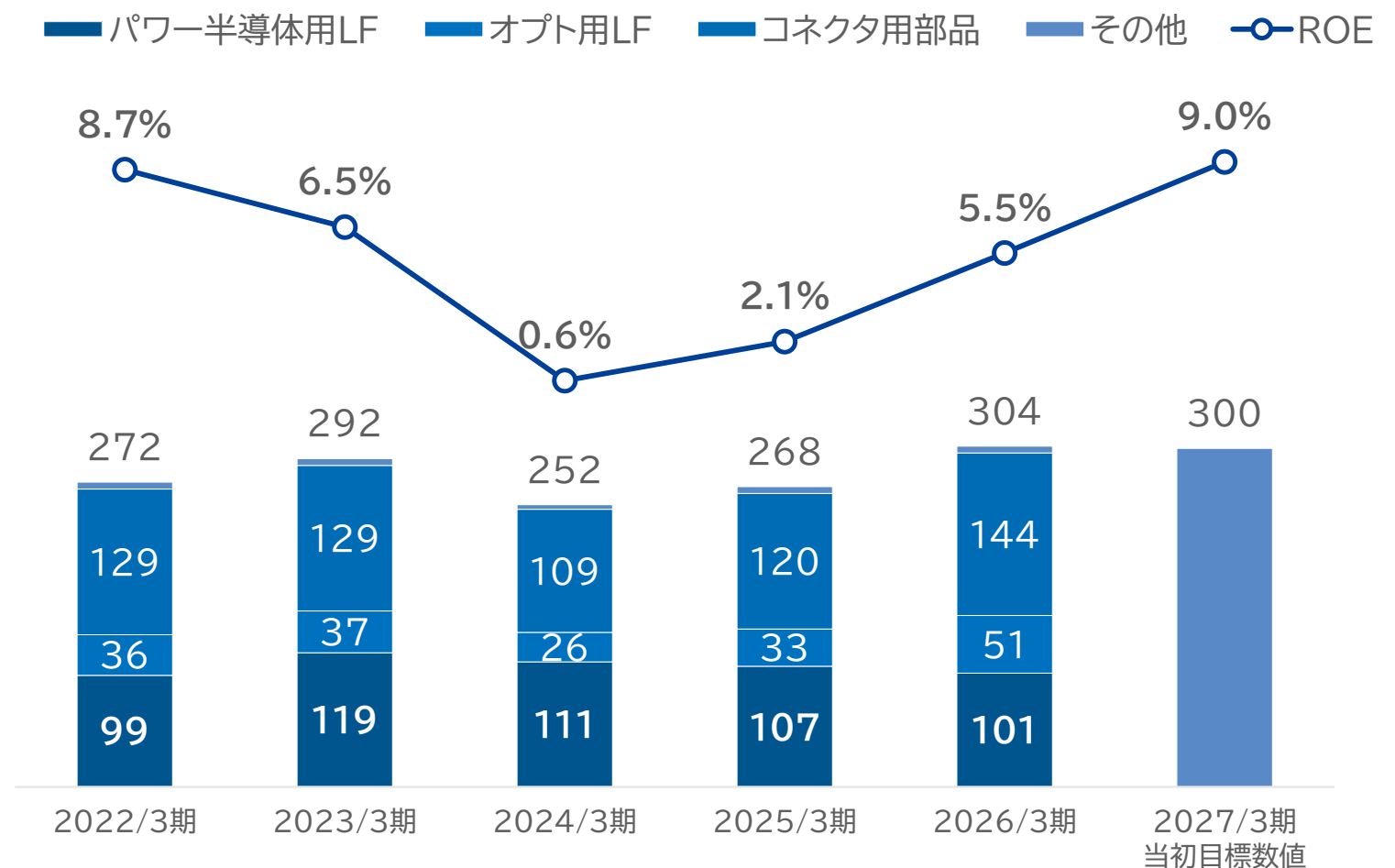
2nd STEP最終年度 当初目標数値

売上高
300億円

営業利益
24億円
(利益率8.0%)

ROE
9%

売上高・ROE

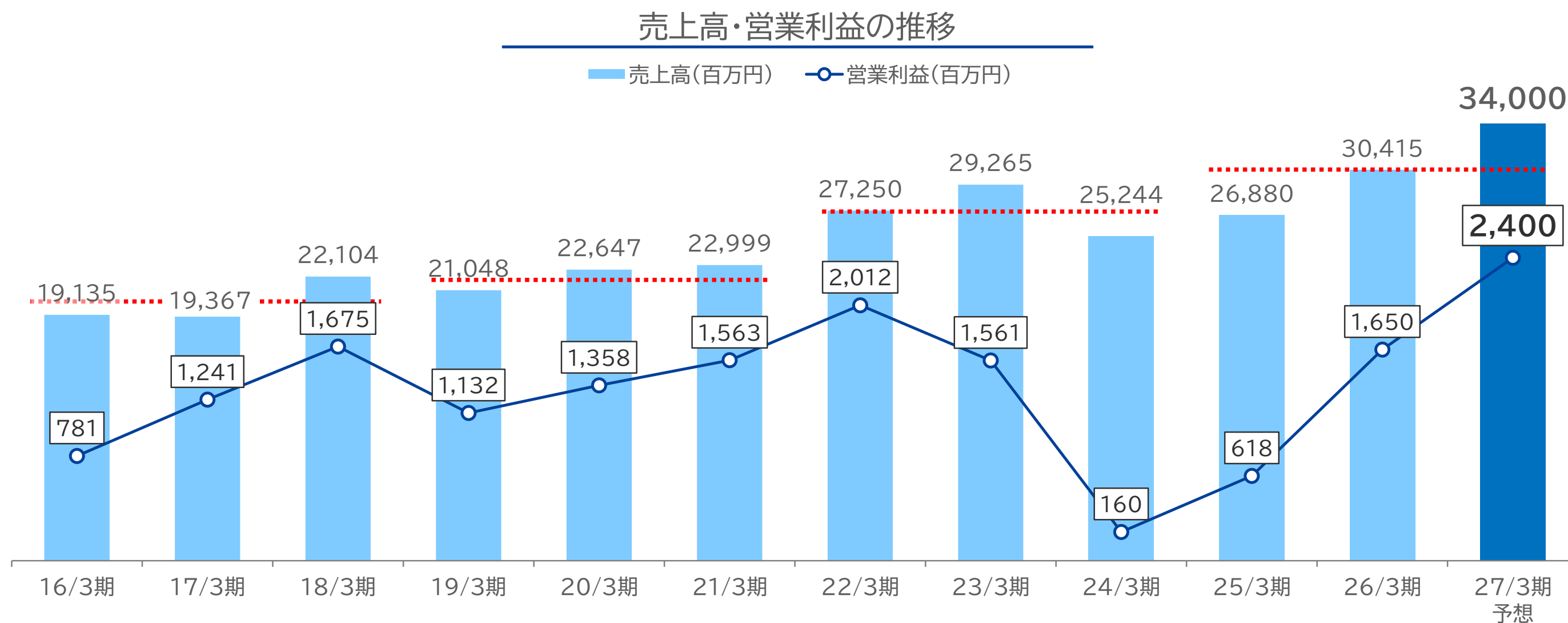


中長期成長目標

- ・『ビジョン2030』では、付加価値率の向上を軸とした各種施策で、主力製品のマーケット成長を上回る売上・利益成長を図る
- ・『2nd STEP』では、車載向けリードフレームの生産拡大、ハイエンドLEDの強化、メッキ内製化による生産性向上を実現する
- ・『2nd STEP』の主要施策はほぼ当初計画に沿って進捗



- 『ビジョン2030 1st STEP』は、22年3月期に過去最高益を計上したが、24年3月期は民生・産業機器向けの調整で大幅減益
- 『2nd STEP』では、LED用リードフレームの拡大やコネクター部品の回復により、27年3月期の営業利益を24億円へ上方修正、最高益を更新し、中期経営計画達成を目指す



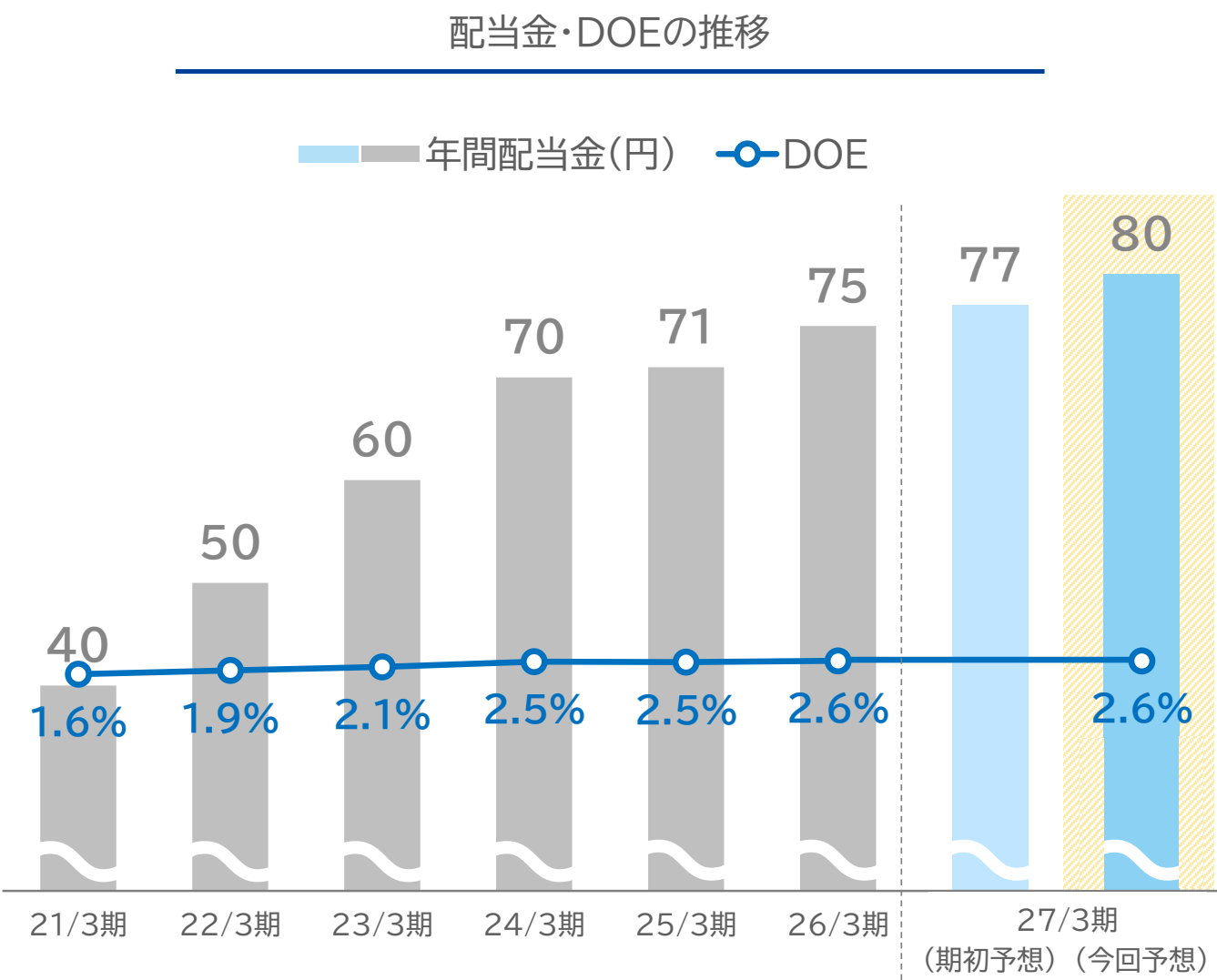
- 2023年5月に配当方針をDOE2.5%以上に変更
- 27年3月期は売上高・営業利益を上方修正、配当も中期経営計画で目標としていた77円から増配し、80円を計画
- 業績は24年3月期をボトムに回復、資本効率向上によるROEの引上げと、株主還元の一層の強化のため、50万株を上限に自己株取得を決定

2024年3月期以降の配当方針

- DOE2.5%以上を配当の数値基準とする
- 中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2027年3月期は80円配当を予定
(DOE2.5% DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本)

自己株式取得を決定

- 取得総数:50万株(上限)、取得価額:16億円(上限)
- 期間:2026年8月12日から27年5月31日
- 目的:資本効率向上と株主還元強化





注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。